

第 10 届中国金刚石相关材料及应用学术会议

(第二轮通知: 会议征文时间延长至 2016 年 6 月 10 日)

第 10 届中国金刚石相关材料及应用学术会议定于 2016 年 7 月 20-23 日在新兴金刚石工具产业园区江西鄱阳县召开。会议旨在为超硬材料及相关领域的专家、学者、技术人员及企业家等提供学术交流平台, 加强国内同行业之间的相互了解和合作, 共同促进我国超硬材料行业及相关行业的蓬勃发展。本届会议将由华侨大学承办。为了保证会议的高质量进行, 现将会议征文时间延长至 2016 年 6 月 10 日, 并欢迎国内外学者和研究人员踊跃投稿。投稿要求具体如下:

一. 会议征文范围

会议征文包括以下几个方面, 但不仅限于此:

1. 超硬材料的合成与性能表征;
2. 超硬材料制品及工具;
3. 金刚石和立方氮化硼薄膜材料;
4. 超硬材料工具的加工过程、机理、仿真及优化;
5. 超硬材料相关的仪器、设备;
6. 与超硬材料相关的辅助材料等;
7. 新型超硬材料及超硬功能陶瓷、热电材料设计、制备及应用。

二. 论文要求

会议将整理印制论文集, 并在征集的论文中遴选一部分作为大会发言稿。凡未在国内外学术刊物或会议上发表过的论文均可投稿。优秀论文将安排在《超硬材料工程》《金刚石磨料磨具工程》等杂志上发表。

论文均用 Word 文档排版(A4 页面; 页边距: 上 2.5cm、下 2cm、左 2.5cm、右 2.0cm), 内容包括: 题目(加粗楷体三号字), 作者、单位、联系电话、地址、邮编(均为楷体小四号字), 摘要、正文及图表和参考文献(均为楷体五号字)等。

论文请用电子邮件传送至: diamond_hqu@hqu.edu.cn。论文提交截止日期为 2016 年 6 月 10 日。

三. 联系方式

地址: 福建省厦门市集美大道 668 号, 华侨大学制造工程研究院

邮编: 361021

联系人: 黄国钦(18959290151)、伍伯妍(18850573086)

电话: (0592) 6162359, 传真: (0592) 6162359 (注明 10thCCADRM)

电子邮箱: diamond_hqu@hqu.edu.cn

会议网址: <http://ime.hqu.edu.cn/> (详情请登录会议网址)